

Title (en)
PROCESS AND DEVICE FOR THE ELECTROLYTIC DIP-COATING OF PLATES, IN PARTICULAR ELECTRIC PRINTED CIRCUIT BOARDS.

Title (de)
TAUCHVERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ELEKTROLYTISCHEN BESCHICHTEN VON PLATTEN, INSBESONDERE VON ELEKTRISCHEN LEITERPLATTEN.

Title (fr)
PROCEDE ET DISPOSITIF POUR LE REVETEMENT ELECTROLYTIQUE AU TREMPE DE PLAQUES, EN PARTICULIER DE PLAQUETTES DE CIRCUITS ELECTRIQUES IMPRIMES.

Publication
EP 0344160 A1 19891206 (DE)

Application
EP 88900227 A 19871218

Priority
DE 3643746 A 19861220

Abstract (en)
[origin: WO8804700A1] A process and device are disclosed for the electrolytic dip-coating of stationary plates (13), in particular electric printed circuit boards, with a metal in a container (1) filled with an electrolyte in which at least one anode (4) and the cathodically polarised plates (13) are dipped at a distance from each other, and on the surface of which an electrolyte stream is generated by electrolyte jets (25) produced below the surface (24) of the electrolyte and directed against the plates (13). The metal is thus not simultaneously deposited on all cathodically polarised areas of the plates (13), but repeatedly on moving areas on the plates (13), as the electrolyte jets (25) impinge on the plates (13) for that purpose.

Abstract (fr)
Procédé et dispositif de revêtement électrolytique au trempé de plaques au repos (13), en particulier de plaquettes de circuits électriques imprimés, avec un métal dans un récipient (1) contenant un électrolyte dans lequel une anode (4) au moins et les plaques polarisées cathodiquement (13) sont trempées à une certaine distance les unes des autres et à la surface duquel un courant électrolytique est engendré par des jets d'électrolyte (25) envoyés sous la surface (24) de l'électrolyte, en direction des plaques (13). Le métal n'est donc pas déposé simultanément sur toutes les zones des plaques (13) polarisées cathodiquement mais à maintes reprises sur les zones en mouvement des plaques (13) tandis que les jets d'électrolyte (25) sont répandus sur les plaques (13) à cette fin.

IPC 1-7
C25D 5/08

IPC 8 full level
C25D 5/04 (2006.01); **C25D 5/08** (2006.01); **H05K 3/24** (2006.01)

CPC (source: EP US)
C25D 5/04 (2013.01 - EP); **C25D 5/08** (2013.01 - EP US); **H05K 3/241** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)
See references of WO 8804700A1

Designated contracting state (EPC)
CH DE FR LI

DOCDB simple family (publication)
DE 3643746 A1 19880630; EP 0275512 A1 19880727; EP 0344160 A1 19891206; WO 8804700 A1 19880630

DOCDB simple family (application)
DE 3643746 A 19861220; EP 8700795 W 19871218; EP 87118826 A 19871218; EP 88900227 A 19871218